

免洗焊锡膏

特性:

- 良好的湿润性, 对于无引脚装置也能很好润湿
- 降低Micro-BGAs下的空洞
- 透明低残留物可探针检测
- 宽广的印刷工艺窗口
- 兼容气相焊接
- 24小时钢网停留时间
- 粘附时间 12-14小时

描述:

NC257设计用于提供宽广的印刷工艺窗口, 优秀的润湿性和探针检测。NC257极佳的润湿性能使焊点表面光滑闪亮, 减少焊锡珠。它仍具有非常低的焊后残留, 其尚存的透明残留物易被针刺穿。此款焊锡膏在回焊中有一个化学过程, 为环境控制设备不良的企业延长焊锡膏使用期限提供了一个最低限和温度差。

印刷:

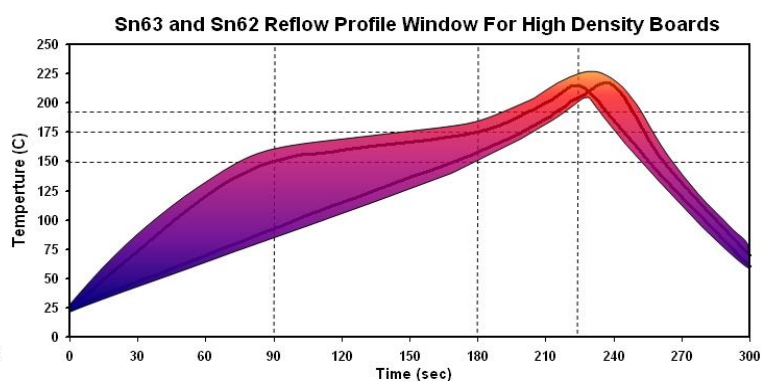
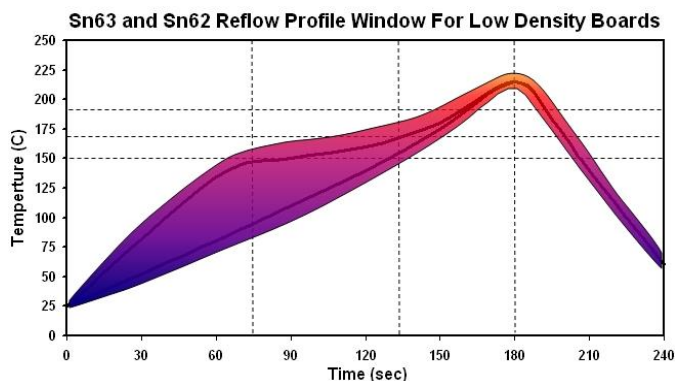
- 在丝网上放上足够的焊膏, 以使其在印刷循环期间能产生平稳均匀的滚动效果。通常在滚动的直径为12到16mm (1/2到5/8英寸) 时即可开始。
- 可以在一定的时间间隔向丝网上施加少量的新焊膏, 以保持焊膏的化学和使用性能。
- NC257可为当今的高速贴片设备提供足够的粘附时间和粘附力。提高产品的性能和可靠性。

以下推荐的印刷机初始设定取决于PCB和PAD设计

直径	推荐初始设定	参数	推荐初始设定
刮刀压力	0.10-0.30千克/厘米(.6 - 1.7 磅/英寸.) 每刀片	PCB 分离间距	0.75-2.0 毫米 (.030-.080")
刮刀速度	12-150 毫米/秒 (.5-6"/秒)	PCB 分离速度	慢
接触距离	接触 0.00 毫米 (0.00英寸)		

回流曲线:

两种典型回流曲线说明如下: 他们既可用于 Ramp-Spike, 也可用于 Ramp-Soak-Spike, 他们回流温度相似。两个回流曲线不同处, 他们达到各自的最高温度, 以及液相线以上时间(TAL)。短回流曲线图将适用于较小的组件, 长回流曲线图适用于较大的组件, 如背板或高密度板。阴影部分定义为 工艺窗口。炉子的效率、板子尺寸、质量、元器件类型和密度都影响最终的回流曲线。这两个曲线图为起始点, 建议使用附有热电偶的实装板进行工艺优化。



升温斜率 1.5-2°C / SEC MAX	升温到 150°C (302°F)	150°C-170°C (302°F-338°F) 之间时间	220°C-210°C (428°F-410°F) 到峰值温度	183°C (381°F) 温度以上	冷却温度 ≤ 4 °C / 秒	曲线长度, 室温至冷却
Short Profiles	≤ 75 Sec	30-60 Sec	45-75 Sec	30-60 Sec	45± 15 Sec	2.75-3.5 Min
Long Profiles	≤ 90 Sec	60-90 Sec	45-75 Sec	60-90 Sec	45± 15 Sec	4.5-5.0 Min

兼容产品:

- NC系列锡膏助焊剂, 免洗粘性助焊剂
- NC270WR VOC-Free免洗喷雾助焊剂
- NC264-5免洗喷雾/泡沫助焊剂
- 免洗Glowcore锡线
- 单步式底部填充胶688
- Epoxy 4044倒装芯片环氧树脂胶

清洁:

- 如果有必要, NC257可采用加有皂化剂的水或适当溶剂清洗剂清洗。
- 欲获得适当的清洗材料一览表, 请参见AIM的免清洗剂表。

处理及储存:

- NC257在4° C-12° C (40° F-55° F) 温度下冷藏保存期为6个月。
- 打开密封使用焊膏之前, 使焊膏充分且自然的升温至室温 (建议放置8小时)。
- 轻而彻底的混合该产品(最长1-2分钟), 以保证由于储存而分离的所有材料都能分布均匀。
- 请勿将新的和使用过的焊膏储存在同一容器中。不使用时, 要将所有的容器重新密封。
- 替换与500克罐子的盖子连在一起的内盖, 以确保最佳的密封效果。

物理特性:

项目	SPECIFICATION
外观	灰色、光滑的油脂状
合金	Sn63 and Sn62
熔点	183°C
金属粉末型号	T3, T4, T5
金属含量	89.5% (T3)
粘度	可提供印刷、点涂版本
包装	符合所有工业包装标准

测试数据小结:

CLASSIFICATION			
Product Name	IPC Classification to J-STD- 004	Copper Mirror to J-STD- 004B	Silver Chromate to J-STD- 004B
NC257	ROL0	LOW	Pass
POWDER TESTING			
No.	Item	Results	Test Method
1	Powder Size	Type 3 – 45-25 micron Type 4 – 38-20 micron	J-STD- 004B IPC TM 650 2.2.14
3	Powder Shape	Spherical	Microscope
FLUX MEDIUM TESTING			
No.	Item	Results	Test Method
1	Acid Value	150.02 mg KOH/ g flux	J-STD- 004B IPC TM 650 2.3.13
2	Halide Content	<300 ppm	J-STD- 004B IPC TM 650 2.3.35
3	Fluorides Spot Test	No fluoride	J-STD- 004B IPC TM 650 2.3.35.1 J-STD- 004B IPC TM 650 2.3.35.2
4	Corrosivity Test/ Copper Mirror	L	J-STD- 004B IPC TM 650 2.3.32
5	Corrosion Flux	Pass	J-STD- 004B IPC TM 650 2.6.15
6	Halide-Free/Silver Chromate Paper Test	Pass	J-STD- 004B IPC TM 650 2.3.33
7	Surface Insulation Resistance	Control Coupons > 1E9Ω at 96 & 168 h. - Pass Sample Coupons > 1E8Ω at 96 & 168 h. - Pass > No dendrite growth or corrosion, after a visual inspection - pass	J-STD- 004 IPC TM 650 2.6.3.3
8	Telcordia (Bellcore) SIR	35°C, 85% 4 days Initial: 8.43E+12Ω Final : 8.03E+12Ω Must be > 1.0E+10Ω - pass	GR-78-CORE
9	Telcordia (Bellcore) Electromigration	65°C, 85% 500 hrs Initial: 1.94E+10Ω Final : 2.08E+10Ω Rf/Ri > 0.01 - pass	GR-78-CORE
10	Compatibility Test	See list of recommended products above	GR-78-CORE
VISCOSITY TESTING			
No.	Item	Results	Test Method
1	T-Bar Spindle Test Method	670 ± 10% kcps	J-STD- 005 IPC TM 650 2.4.34
SOLDER PASTE TESTING			
No.	Item	Results	Test Method
1	Tack Test	32.8 gf	J-STD- 005 IPC TM 650 2.4.44
2	Tack Test	94.8 gf	JIS Z 3284 Annex 9
3	Solder Ball Test	Pass	J-STD- 005 IPC TM 650 2.4.43
4	Wetting Test	Pass	J-STD- 005 IPC TM 650 2.4.45
5	Paste Shelf Life	4°C (39°F) = 6 months	AIM TM 125-11
6	Solder Paste Slump Test	Pass	J-STD- 005 IPC TM 650 2.4.35

加拿大 +1-514-494-2000 · 美国 +1-401-463-5605 · 墨西哥 +52-656-630-0032 · 欧洲 +44-1737-222-258
 亚太地区 +86-755-2993-6487 · 印度 +91-80-41554753 · info@aimsolder.com · www.aimsolder.com
 AIM已通过ISO9001:2008及ISO14001:2004认证

以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。所有信息中的焊锡膏由 45 微米焊粉生产而成。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/Home/TermsConditions.aspx> 查询 AIM 相关条款。